

长电科技 2024 年第三季度业绩说明会记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00-16:30 通过进门财经电话会议、上证路演中心网络文字互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事/首席执行官（CEO）郑力先生、独立董事李建新女士、首席财务长徐阳先生、董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员就公司 2024 年第三季度经营成果及财务具体情况与近 210 位机构及个人投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

1. 公司营收创出了新高，不过第三季度单季毛利率环比有一些下滑，是否能稍微展开介绍，有多少是因为客户占比提高所导致的。另外除了我们部分产品毛利率比较低的这个因素之外，其他的部分毛利率大概是一个什么样的变化状态。然后我们现在在旺季产能利用比较高的情况下的这个季度的毛利率是不是对未来是有一定的参考性。

第三季度毛利率环比有所下降，主要有几个原因：第一个原因是公司先进的高密度系统封装模组的出货量显著的增加。我们通讯，智能手机市场收入占比大幅提升。同时非通讯领域的需求复苏较为平缓，所以我们第三季度的产品组合和上半年相比变化较大。高密度系统封装模组本身，由于客户的产品迭代升级，原材料成本的占比更高。两方面原因叠加造成了三季度毛利率波动的情况。当前公司正加速业务结构向先进封装领域的战略升级，也持续加大了对高性能封装技术的投资布局力度。各个工厂也都在推进新产品和新技术的导入，力求实现创新转型的顺利跨越，伴随着这个转型，也有大量的高端的新设备投入及高性能原材料更换升级的要求以及支出。这从另外一个方面也导致了成本压力在短期内的有所增加。最后就是从去年下半年开始的一些客户降价的影响还有一些持续，部分成熟封装的价格还没有走到历史的水平。第四季度的毛利率相较第三季度有望稳定和逐步改善。我们也在继续推进产品结构和材料成本的优化，提拉高质量高附加值的产品。对一些低毛利的订单也在减量。同时在经营方面进一步加大降本增效的力度，提升重点产线的产能利用率。

2. 三季度通信业务，营收比我们同业好非常多。这里面是不是有市场份额提升的原因，增长的趋势能不能延续到 2025 年？然后如果看汽车业务的话，其实虽然同比是有增长，但感觉环比是略有下滑。所以我想问这个部分更多是因为需求还是因为价格？

通信业务实现了 30% 的增长，公司在一些创新产品上取得了较大的市场份额。与智能手机市场的平均增长相比，我们的增长幅度更为显著。在一些新产品的市场份额上看到明显的提升。

汽车业务在第三季度实现了 50% 的同比增长，这一表现超出了汽车市场的平均走势，符合我们的预期，并且也超越了年初设定的全年汽车业务增长目标。总体来看，燃油车供电系统向 48 伏转换的趋势正在带来一系列新的芯片需求，尤其是对封装领域提出了新的要求并推动了创新，我们对此持乐观态度。在新能源汽车领域，经过前段时间的大幅增长后，未来芯片供应将成为关键因素，有望推动新能源汽车市场的持续增长。整个汽车半导体库存的调整，根据我们的观察以及主要全球客户的反馈，已接近尾声。未来，新老客户的需求将在长电科技国内外工厂得到稳步回升。

3. 能否拆分一下 Q3 各类下游应用的收入占比的情况。一般来说三季度的话是电子旺季。从现在四季度客户提货的情况来看，需求的持续性怎么样？展望明年的复苏大概是怎么情况，谢谢？

从第三季度来看，以智能手机为核心的通信占 48%，消费类的占到了四分之一，运算类 12%，汽车加工业类是 15%。下半年除了往来的季节性增长及整个集成电路产业的复苏，从封装测试的角度看，这个时期正好是产业从传统封装向先进封装，实现质的进化的过程。先进的产品占比越来越高。通信中面向智能化，AI 手机落地的产品越来越多，是比较明显的趋势。在这样的时期，公司对高端的设备和材料，面向高端先进封装的人员配置以及生产制程上所投入的资源越来越大。随着先进封装的不断发展，虽然收入在增加，但毛利率却有所下降，这主要是由于对高端技术和高端工艺的投入加大所致，然而我们认为这是一个积极的信号。

在晶圆厂或者同行里边过去也有类似的情况，当技术跃升的时候，投入势必会影响毛利率。做跳跃的时候，要有下蹲的准备动作。大家可以看到人工智能从局端扩展到终端推向更加巨量的市场情况下，像长电科技这样有代表性的有规模的企业，要勇于投入，不仅要在资本上加大投入，还要在各个环节增加投入，来拥抱技术革新的时代，我们非常看好面向更加智能化产品的技术研发和产品的落地，会持续给行业带来超出以往的季节性的发展。

4. XDFOI®先进封装平台最新的研发和客户导入进展如何？如何看待在国内具备 2.5D/3D 封装能力企业之间公司的优势？这部分是以国内客户为主还是也有拓展海外客户？

先进封装和智能化的趋势是紧密相关的。长电科技的优势，主要有两点。一是先进封装的规模比较大，所以必须要有大规模的承接能力，全球的头部厂商才具备的规模优势；再有就是客户的多元化，面向先进封装，国内及海外，无论是头部大客户，还是国内外的主流客户，都有面向智能化发展的先进封装产品在导入。

从大的局势来看，先进封装是将来主流的 OSAT 厂商在产能规模和技术方面的必备项。另外，它也是客户产品的必选项。长电微及公司海外的产能建设都围绕先进封装做了一定程度产能和相关工艺前置的投入，并不断走向高端化，是我们对先进封装平台的规划安排，这能够发挥主流封装厂的优势。

和晶圆厂的合作分工越来越明显。大家可以看到，晶圆厂和封装厂的合作也越来越深入，各自都有各自的优势。这样的产业合作结合，肯定会把先进封装推向一个更广、更加普及的发展平台。

5.公司当前对国内和海外半导体周期的感受情况如何？今年其实国内会稍微强一点，海外会弱一点，明年的判断？

明年我们看海外的客户，在工业和汽车电子库存的调整已经慢慢见底，所以我们相信海外客户在明年的表现，包括新产品的推出，肯定会要比今年更加积极。同时海外客户的强项在人工智能方面，行业看法是人工智能会明显的从数据中心向终端落地，所以对明年的海外市场非常看好。

国内市场方面，人工智能向终端发展的势头今年刚刚开始，明年预计会持续下去。今年国内采取的一系列推动经济产业发展的措施，对明年的国内市场的发展都是非常积极的。

6. 今年 Q3、Q4 我们分各个厂区来看稼动率的情况怎样，还有到今年 Q4 到明年 Q1 的变化情况大概是怎么样的？

产能利用率相比二季度还是在逐步提升的，也是帮助公司达到了单季营收历史新高。目前来说，我们晶圆级封装为主的先进封装以及高端测试领域已经达到了满产的状态。同时公司也在积极扩展，满足客户持续的需求。相对来讲，传统封装的复苏要弱一些。第四季度公司产能利用率继续维持当前的水平，产品结构会有所变化。明年来看的话我们认为市场将延续这个上行周期的趋势，随着人工智能进一步展开，带动新应用和新技术的落地。工业和汽车等市场的复苏，公司的运营将进一步成长。

7. 因为公司现在持有的现金和现金流情况都比较好，我们对未来几年资金规划如何，包括 capex，会有更多外延动作吗？

公司现在的现金和现金流情况是比较好。针对半导体行业重资产的这个特性，公司还会持续优化我们的营运经营效率，确保稳定的自由现金流，保持充足的现金准备。未来我们会持续增加资本支出的力度，不断扩大面向先进封装技术和产能的投入，满足高性能运算、高端存储、汽车电子以及功率与高密度电源管理领域不断增长的客户需求。增加研发投资的水平，深化与客户的联合创新。在当前的市场趋势下，其实拥有我们这样比较雄厚的资金实力，并能够持续大规模保持在先进封装领域投资的企业并不多，这也是我们的一个显著的竞争优势。

同时公司也将合理的运用金融工具，积极筹措资金，以应对公司内生和外延发展的资金需求，保障战略规划落地。我们会继续挖掘国内外优秀半导体工厂的并购机遇，并做好战略投资项目的支持，推进长电为新产能的提升，加速临港汽车工厂的建设进程以及晟碟工厂的融合，完善公司的产业布局。同时除了现有的地区以外，我们也在积极准备配合客户以及晶圆厂的要求，进一步丰富我们在海外的布局。

最后在股东回报方面，公司已经持续四年保持分红，未来将结合最新的经营情况和发展规划，在符合条件的情况下，积极推动增加对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平，持续为股东创造长期价值。

8. 晟碟收购进来后，管理上有什么措施加强整合？晟碟员工是否会做股权激励，大致什么规模？另外在整合初期，资本支出和三费支出，会有哪些具体的增加，晟碟的净利是否会有一些波动？

我们很高兴晟碟半导体能够融入到长电科技的大家庭，为我们带来更多的营收和利润增长。公司已经组织各总部条线与晟碟半导体进行对接，加速融合进程。公司与西数有长达 20 多年的业务关系，收购晟碟半导体后将进一步加强两者的战略合作。

对长电科技及晟碟而言，保障员工的稳定性和持续发展是非常重要的工作，所以长电会采取各项措施和选项，来留住人才，培养和发展人才，我们会积极的推进这一工作。

在这个融合的初期会有与项目相关的一些合理费用的产生，但金额不会太大。合资公司的董事会会按照业务需求对资本支出进行审批，这些资本支出主要还是与产能投资、产线升级相关的。这些安排在收购之前都有约定。此外晟碟半导体的管理层也会持续关注营运支出的费用，确保这个营运支出的费用的稳定以及持续的优化。

9. AI 相关的近期取得哪些进展？是在国内还是海外市场？新业务什么时候会进入收获期？

在存、算、光电一体化领域，无论是客户新产品的导入，还是我们所看到的订单规模和生产规模，都比去年有了非常明显的提升。这种趋势在海外和国内都同样明显。除了算力相关的趋势外，公司在存储和高密度供电、光电合封等方面的投入也在显著增加，包括导入生产的 NPI 和新产品开发的数量都在明显提升。

这方面的投入增长幅度甚至超过了收入的增长幅度。新技术革新在方兴未艾的时期，出现这样的结果也是必然的。因此毛利率有所回落也反映了公司正在积极向先进封装领域进行大规模投入。大规模的投入自然需要更多的新项目来支撑。

新的业务正在逐渐步入佳境。先进封装已经跻身集成电路的最顶端应用领域，与传统的封装不同，它并非投入后三四个月就能见到结果，而是更像晶圆制造那样，需要一两年的周期。随着整个终端市场应用的渗透和普及，现在投入的新产品和项目也将逐渐显现成果。我们对此感到非常兴奋，并充满信心地迎接更新、更加高端的产品在先进封装领域的出现。

10. 请介绍上海临港什么时候可以投产？还有和华润的股份交接事宜？和华润控股的华润微同业竞争的问题？

1) 临港工厂将于明年下半年通线。2) 本次与华润相关的股东权益变动事项仍在进行中。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关及后续公告。

11. 公司 3 季度库存增加 39% 背后的原因为何？是大客户备货吗？这是不是能说明公司四季度营收增长动能会很强？

第三季度存货增加，主要与晟碟资产负债表并表有关。第四季度开始将实现晟碟的全面并表，包括损益表，对公司第四季度业绩有所贡献。

12. 请问怎么看 ASML 今后的对华策略？

公司与海外设备和材料供应商均保持长期良好的合作关系。

13 请问贵公司是否具备类似于台积电的 cowos 的 2.5D 封装技术以及 sk 海力士的 HBM 的 3D 封装技术？如果具备，目前是否已经量产？良率如何？

先进封装技术在半导体市场越发重要的趋势正不断得到加强，已经成为行业的共识。针对未来技术和需求的发展趋势，公司持续推进多样化方案的落地及海内外产能的建设，需要更多的资金和加强服务客户的能力。越来越多的客户计划采用先进封装，市场的应用数年内将从云端进一步向边缘侧拓展，随着市场规模的进一步扩大，也将有利于领先的封测厂进一步参与，我们将跟客户做好紧密的合作，随着客户产品发力做好配合。

14.1) 目前贵公司与华润集团的重组，现进行到什么阶段？针对之前华润微同业竞争问题，日后如何解决，是否有再并购或者重组的预期？2) 自从贵公司CTO 离职之后，该职位一直悬空，目前是否有合适人选加入贵公司？

1) 本次公司股东权益变动事项仍在进行中。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关及后续公告。2) 公司技术研发工作在国内外研发负责人的带动下有序推进并不断取得新的突破，得到主要客户认可。近期不断有国际上的顶尖技术人才加入公司。欢迎大家持续关注。